### SFH 9500



#### Features:

- Suitable for surface mounting (SMT)
- Compact housing out of black LCP
- GaAs infrared emitter (950 nm)
- Silicon phototransistor with daylight-cutoff filter
- · With positioning pin
- · Suitable for pick and place
- High sensing accuracy (slit width: 0.5 mm)
- Wide gap between emitter and detector (5 mm)
- High stability on pcb due to large width of device (6.8 mm)

#### **Applications**

- Speed control
- Motor control
- Monitoring of paper feed in printers, copiers, facsimiles
- · Disk drives
- · Control of print head in printers
- Coin detection
- · Optoelectronic switches

#### **Besondere Merkmale:**

- Geeignet f
  ür Oberfl
  ächenmontage (SMT)
- Kompaktes Gehäuse aus schwarzem LCP
- GaAs-IR-Sendediode (950 nm)
- Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
- Mit Positionspin
- · Geeignet für "pick and place" Montage
- Hohe Genauigkeit (Schlitzbreite: 0,5 mm)
  - Große Spaltbreite zwischen Sender und Empfänger (5 mm)
  - Hohe Stabilität auf PCB durch große Bauelementabmessung (6,8 mm)

### Anwendungen

- · Geschwindigkeitsüberwachung
- Motorsteuerung
- Überwachung des Papiervorschubs in Druckern, Kopier- und Faxgeräten
- Speicherlaufwerke
- Steuerung des Druckkopfes in Druckern
- Münzdetektion
- · Optoelektronische Schalter

## Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Collector-emitter current	Ordering Code
Тур:	Kollektor-Emitterstrom	Bestellnummer
	I <sub>F</sub> = 20 mA, V <sub>CE</sub> = 5 V	
	I <sub>PCE</sub> [μΑ]	
SFH 9500	≥ 1000	Q65110A3108

2011-07-12



Maximum Ratings (T<sub>A</sub> = 25 °C) Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einhei
Emitter Sender			
Reverse voltage Sperrspannung	V <sub>R</sub>	5	V
Forward current Durchlassstrom	I <sub>F</sub>	60	mA
Total power dissipation Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	100	mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 10 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung 1) Seite 10	R <sub>thJA</sub>	280	K/W
Detector Empfänger			
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V <sub>CE</sub>	30	V
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung (t ≤ 2 min)	V <sub>CE</sub>	70	V
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V <sub>EC</sub>	7	V
Collector current Kollektorstrom	I <sub>C</sub>	50	mA
Total power dissipation Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	150	mW
Thermal resistance junction - ambient <sup>1) page 10</sup> Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <sup>1) Seite 10</sup>	R <sub>thJA</sub>	280	K/W
Slotted Interrupter Gabellichtschranke			
Storage temperature range Lagertemperatur	T <sub>stg</sub>	-40 85	°C

2011-07-12

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Ambient temperature range Umgebungstemperatur	T <sub>op</sub>	-40 85	°C
Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung	V <sub>ESD</sub>	2	kV
Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung	R <sub>thJA</sub>	280	K/W

## Characteristics ( $T_A = 25$ °C)

## Kennwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit

## Emitter Sender

Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge	$\lambda_{peak}$	950	nm
Forward voltage Durchlassspannung (I <sub>F</sub> = 20 mA, t <sub>P</sub> = 20 ms)	V <sub>F</sub>	1.2 (≤ 1.4)	V
Reverse current Sperrstrom (V <sub>R</sub> = 5 V)	I <sub>R</sub>	0.01 (≤ 1)	μΑ
Capacitance Kapazität (V <sub>B</sub> = 0 V, f = 1 MHz)	C <sub>0</sub>	16	pF

## Detector Empfänger

Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{\text{S max}}$	920	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	λ <sub>10%</sub>	840 1080	nm
Capacitance Kapazität (V <sub>CE</sub> = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)	C <sub>CE</sub>	6.5	pF



Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Dark current Dunkelstrom (V <sub>CE</sub> = 20 V)	I <sub>CEO</sub>	2 (≤ 50)	nA
Interrupter Lichtschranke			
Collector-emitter current Kollektor-Emitterstrom (I <sub>F</sub> = 20 mA, V <sub>CE</sub> = 5 V)	I <sub>PCE</sub>	1000	μΑ
Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung ( $I_F = 20 \text{ mA}, I_C = 0.3 \text{ mA}$ )	V <sub>CEsat</sub>	≤ 0.4	mV
Switching Times Schaltzeiten			
Rise time Anstiegzeit $(V_{CC} = 5 \text{ V}, I_{C} = 1 \text{ mA}, R_{L} = 1 \text{ k}\Omega)$	t <sub>r</sub>	13	μs



17

μs

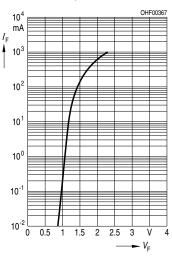
Fall time

Abfallzeit

 $(V_{CC}=5~V,~I_{C}=1~mA,~R_{L}=1~k\Omega)$ 

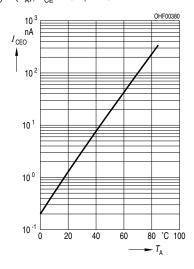
## **Forward Current** Durchlassstrom

 $I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_D = 100 \mu s$ ,  $T_A = 25^{\circ}C$ 



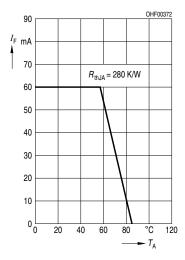
## **Dark Current** Dunkelstrom

 $I_{CEO} = f(T_A), V_{CE} = 20 \text{ V}, E = 0$ 



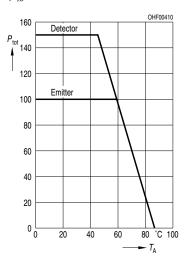
## Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom

 $I_F = f(T_A)$ 



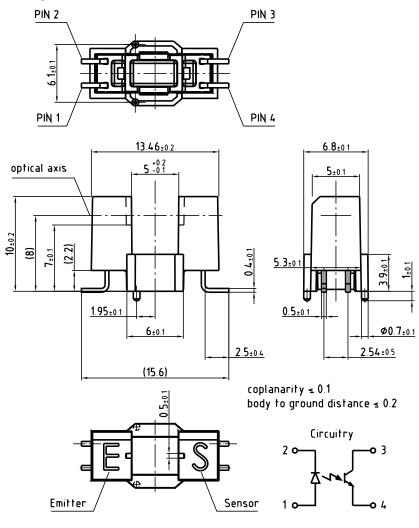
## **Total Power Dissipation** Verlustleistung

 $P_{tot} = f(T_A)$ 





## Package Outline Maßzeichnung

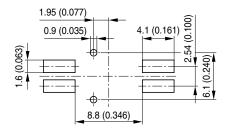


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

C63062-A3402-A1-04

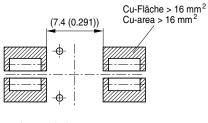
Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign

/

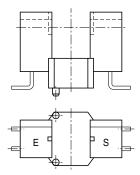


Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung

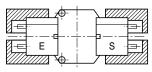
Paddesign for improved heat dissipation







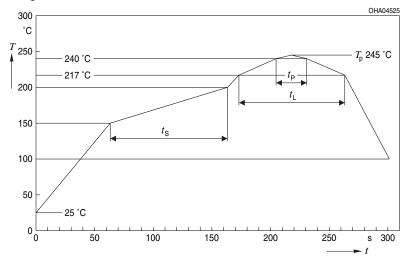
Bauteil positioniert Component Location on Pad



OHFY1950

# Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 1 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



0				

Profile Feature	Symbol	Pb-Fi	Unit		
Profil-Charakteristik	Symbol	Minimum	Recommendation	Maximum	Einheit
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t <sub>s</sub> T <sub>Smin</sub> to T <sub>Smax</sub>	t <sub>s</sub>	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T <sub>Smax</sub> to T <sub>P</sub>			2	3	K/s
Liquidus temperature	T <sub>L</sub>		217		°C
Time above liquidus temperature	t <sub>L</sub>		80	100	s
Peak temperature	T <sub>P</sub>		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T <sub>P</sub> - 5 K	t <sub>P</sub>	10	20	30	s
Ramp-down rate* T <sub>P</sub> to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T <sub>P</sub>				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component



<sup>\*</sup> slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

#### Disclaimer

OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design in activities based on this preliminary draft version. OSRAM OS may e.g. decide at its sole discretion to stop developing and/or finalising the underlying design at any time.

#### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

#### **Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- \*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- \*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

#### Disclaimer

OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen.

#### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

## Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- \*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- \*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



## Glossary

## Thermal resistance: Mounting on PC-board with > 5 mm<sup>2</sup> pad size

#### Glossar

Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5 mm² Padgröße

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求;

国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

2011-07-12

# **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Osram Opto Semiconductor: SFH 9500-Z